



# 美格智能 SRM813Q模组

5G RedCap轻量化M.2封装  
小尺寸全功能模组

美格智能SRM813Q M.2系列模组是一款专为IoT/eMBB应用而设计的5G RedCap轻量化模组, 基于高通技术公司的骁龙®X35 5G调制解调器及射频系统设计, 符合最新的3GPP Release 17标准及特性, 支持5G独立组网(SA)方式并向下兼容4G网络, 可覆盖全球主流运营商网络, 同时可支持全球GNSS定位功能。可支持64QAM/256QAM(可选)调制方式, 理论下行峰值速率可达220Mbps, 理论最大上行速率可达120Mbps, 相比4G Cat.4产品可获得更高的上下行速率。

该模组采用M.2封装, 尺寸为30.0x42.0x3.25mm, 符合行业M.2标准接口定义, 可支持USB2.0、两路SIM卡、SPI、多路UART、GPIO等接口, 4G/5G采用2天线设计, 内部预留eSIM支持; 可适配多种类型操作系统(Android, Linux, Windows等), 同时内置了丰富的网络协议。

SRM813Q M.2系列模组具有接口标准、天线数量少、性价比高、底板设计简单、更易升级更换等优势, 将强有力赋能移动宽带、工业互联网、智慧能源、视频监控、笔电、智能穿戴等垂直行业, 加速5G规模化商用。

## 主要优势:

- 5G RedCap轻量化模组, 更高性价比
- M.2标准尺寸和PIN定义, 升级更换更简单
- 两天线全频段设计, 降低5G终端设计复杂度
- 可支持网络切片、5G LAN和高精度授时等特性



5G NR



SA & LTE



M.2封装



USB2.0 Port



-40°C-85°C



VoNR/VoLTE\*

# MeiG Smart SRM813Q模组

5G RedCap轻量化M.2封装小尺寸全功能模组

MEIG 美格

股票代码:002881

## 基本属性:

- 封装: M.2封装
- 尺寸: 30.0×42.0×3.25mm
- 重量: <10g

## 模组速率:

- 5G NR SA:
  - Downlink up to 220Mbps
  - Uplink up to 120Mbps
- LTE:
  - Downlink up to 200Mbps
  - Uplink up to 75Mbps

## 驱动&工具:

- 驱动: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Android
- 工具: 图形化升级工具, 多系统下日志工具
- USB升级, FOTA升级

## 网络协议:

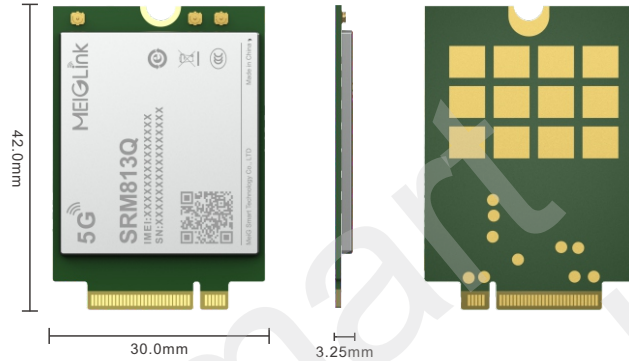
- RNDIS/NDIS/IPv4/IPv6/TCP/UDP

## 模组接口:

- USB2.0 × 1
- USIM × 2 1.8V/3V
- PCM × 1
- GPIOs
- 3个天线接口:
  - 4G/5G x2
  - GNSS x1

## 认证信息:

- CCC\*/SRRC\*/CTA\*/CE\*/FCC\*



## 发射功率:

- Class 3 (23dBm±1.5dB) for 5G & LTE

## 环境温度湿度特性:

- 正常工作温度: -30°C to +75°C
- 扩展工作温度: -40°C to +85°C
- 存储温度: -40°C to +90°C
- 湿度: 5%~95%

## SRM813Q M.2系列频段信息:

### -CN:Region: China

#### 5G NR:

FDD:N1/N5/N8/N28  
TDD:N41/78

#### LTE:

FDD:B1/B3/B5/B8  
TDD:B34/B38/B39/B40/B41

### -NA:Region:North America

#### 5G NR:

FDD:N2/N5/N7/N12/N13/N25/N66/N71  
TDD:N38/N41/N48/N77/N78

#### LTE:

FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B71  
TDD:B38/B41/B42/B43/B48

### -EA:Region:Europe, Australia, Japan, Korea, Southeast Asia

#### 5G NR:

FDD:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28  
TDD:N38/N40/N41/N77/N78

#### LTE:

FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28  
TDD:B38/B40/B41/B42/B43

备注: \* 研发中

